

各 位



平成 28 年 1 月 13 日

会社名	TDK株式会社
代表者	代表取締役社長 上釜 健宏 (コード番号 6762 東証第1部)
問合せ先責任者	広報グループゼネラルマネージャー 丸川 純夫 (TEL 03-6852-7102)

Qualcomm との業務提携ならびに合弁会社の設立に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月 13 日開催の取締役会において、当社ならびに Qualcomm Incorporated (以下、「Qualcomm」)は、同日付でモバイル機器向けの統合システムや、IoT (Internet of Things)、ドローン、ロボット、自動車アプリケーションなどの成長著しいビジネスセグメント向けに高周波フロントエンド (RF FE) モジュールや RF フィルタの提供を行う合弁会社 (RF360 Holdings Singapore PTE. Ltd.) の設立について合意し、Qualcomm の間接所有である 100%子会社の Qualcomm Global Trading PTE. Ltd. (以下、「QGT」) 及び Qualcomm Technologies, Inc. (以下「QTI」) を含む他の Qualcomm 関連会社と当社及び関連会社を当事者とする契約の締結について決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

1. 業務提携ならびに合弁会社設立の理由

当社は、磁性素材技術をベースに電子部品事業を中核事業としておりますが、世界的な普及が継続しているスマートフォンなどの「ICT 分野」、ハイブリッド車や電気自動車を含む「自動車分野」、風力発電や太陽光発電などの「産業機器・エネルギー分野」を重点 3 市場分野とし、それぞれの市場向けに電子部品事業を中心に事業ならびに収益の拡大を鋭意進めております。

世界で最もダイナミックかつ変化の激しい市場の一つとして、モバイル通信のグローバル市場では昨今、全てのプレーヤーに対して様々な要求があります。一例を挙げれば、これからのスマートフォンは 2G、3G、4G LTE といった多くのバンドに対応しつつ、無線 LAN、GPS ナビゲーション、Bluetooth などの多様なワイヤレス環境との接続性も備えていなければなりません。加えて、4G のモバイル通信と IoT の融合により、モバイル機器向けのワイヤレスソリューションを提供するメーカーが、とりわけ RF FE の分野において、今までにない新たな次元の小型化、高集積化、高機能化などの進化を求められています。5G では更なる複合化が進む見込みです。モジュールソリューションは、こうした複合化が進

む RFFE にとって必要不可欠な技術になります。このような背景から、当社のお客様が求めるソリューションをタイムリーに提供するためには、半導体メーカーと一体となった緊密かつスピーディな経営環境の創出が必要不可欠と判断し、世界市場で多くの実績と信頼性の高い最先端の半導体を製造、販売している Qualcomm との合弁会社設立を伴う業務提携を締結することを決定しました。

2. 業務提携の内容等

(1) 業務提携の内容

TDK の 100% 子会社である EPCOS AG (以下、「EPCOS」) が QGT とともに同社の当該事業である高周波事業を運営する持株会社を設立し、持分の過半数を QGT へ譲渡します。その後、EPCOS と QGT はこの持株会社を合弁会社として運営する予定です。

なお、移管されるビジネスは、TDK 全体の一部となる高周波関連ビジネスで、売上は約 10 億 US ドル (日本円で約 1,200 億円) (平成 28 年 3 月期見込み) です。従業員は約 4,200 人を含みます。

(2) 合弁会社の概要

(1) 名 称	RF360 Holdings Singapore PTE. Ltd.
(2) 所 在 地	シンガポール
(3) 代表者の役職・氏名	未定
(4) 事 業 内 容	高周波モジュール、高周波部品の開発、設計、調達、製造、販売等
(5) 資 本 金	未定
(6) 設 立 年 月 日	未定
(7) 決 算 期	未定
(8) 純 資 産	未定
(9) 総 資 産	未定
(10) 出 資 比 率	QGT : 51%、EPCOS : 49%

(注) 未定としている項目については、決定次第開示いたします。

なお、QGT は、クロージング日より 30 カ月後に合弁会社の残りの株式を取得するオプション (および EPCOS は売却するオプション) を保有します。

QGT が、合弁会社の EPCOS の持分を取得するオプションを行使する場合、譲渡価値の総合計は、およそ 30 億 US ドル (日本円で約 3,600 億円) になると見込んでいます。これは、契約締結時の支払いと、合弁会社による RF フィルタの販売や Qualcomm、QTI と TDK の相互協力に係る契約、オプション行使価格など、TDK への将来の追加支払いを含むものです。

3. 業務提携の相手先の概要

(1) 名 称	Qualcomm Incorporated			
(2) 所 在 地	アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ			
(3) 代表者の役職・氏名	Steve Mollenkopf (CEO)			
(4) 事 業 内 容	移動体通信に用いられる通信技術の開発、半導体の設計開発			
(5) 資 本 金	738.6 億米ドル			
(6) 設 立 年 月 日	1985 年 7 月			
(7) 大株主及び持株比率 (平成 27 年 12 月 31 日現在)	BlackRock, Inc. (7.10%) Vanguard Group, Inc. (6.81%) State Street Corporation (4.25%) FMR, LLC (4.17%)			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	資本関係はありません		
	人 的 関 係	人的関係はありません		
	取 引 関 係	当社は当該会社に対し、当社が製造する電子部品の供給を実施しています。		
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。		
(9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態				
	決算期	平成 25 年 9 月期	平成 26 年 9 月期	平成 27 年 9 月期
連 結 純 資 産		36,088,000 千ドル	39,169,000 千ドル	31,421,000 千ドル
連 結 総 資 産		45,516,000 千ドル	48,574,000 千ドル	50,796,000 千ドル
1 株当たり連結純資産		21.35 ドル	23.45 ドル	19.97 ドル
連 結 売 上 高		24,866,000 千ドル	26,487,000 千ドル	25,281,000 千ドル
連 結 営 業 利 益		7,230,000 千ドル	7,550,000 千ドル	5,776,000 千ドル
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益		6,853,000 千ドル	7,967,000 千ドル	5,271,000 千ドル
1 株 当 た り 連 結 当 期 純 利 益		3.91 ドル	4.65 ドル	3.22 ドル
1 株 当 た り 配 当 金		1.20 ドル	1.54 ドル	1.80 ドル

4. 日程

(1) 取締役会決議日	平成 28 年 1 月 13 日
(2) 契約締結日	平成 28 年 1 月 13 日
(3) 事業開始日	未定

5. 今後の見通し

本件による当社の平成28年3月期連結決算への影響についてはありません。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成27年10月30日公表分) 及び前期連結実績

(百万円)	連結売上高	連結営業利益	税引前 当期純利益	当社株主に帰属 する当期純利益
当期連結業績予想 (平成28年3月期)	1,180,000	95,000	95,000	65,000
前期連結実績 (平成27年3月期)	1,082,560	72,459	74,517	49,440